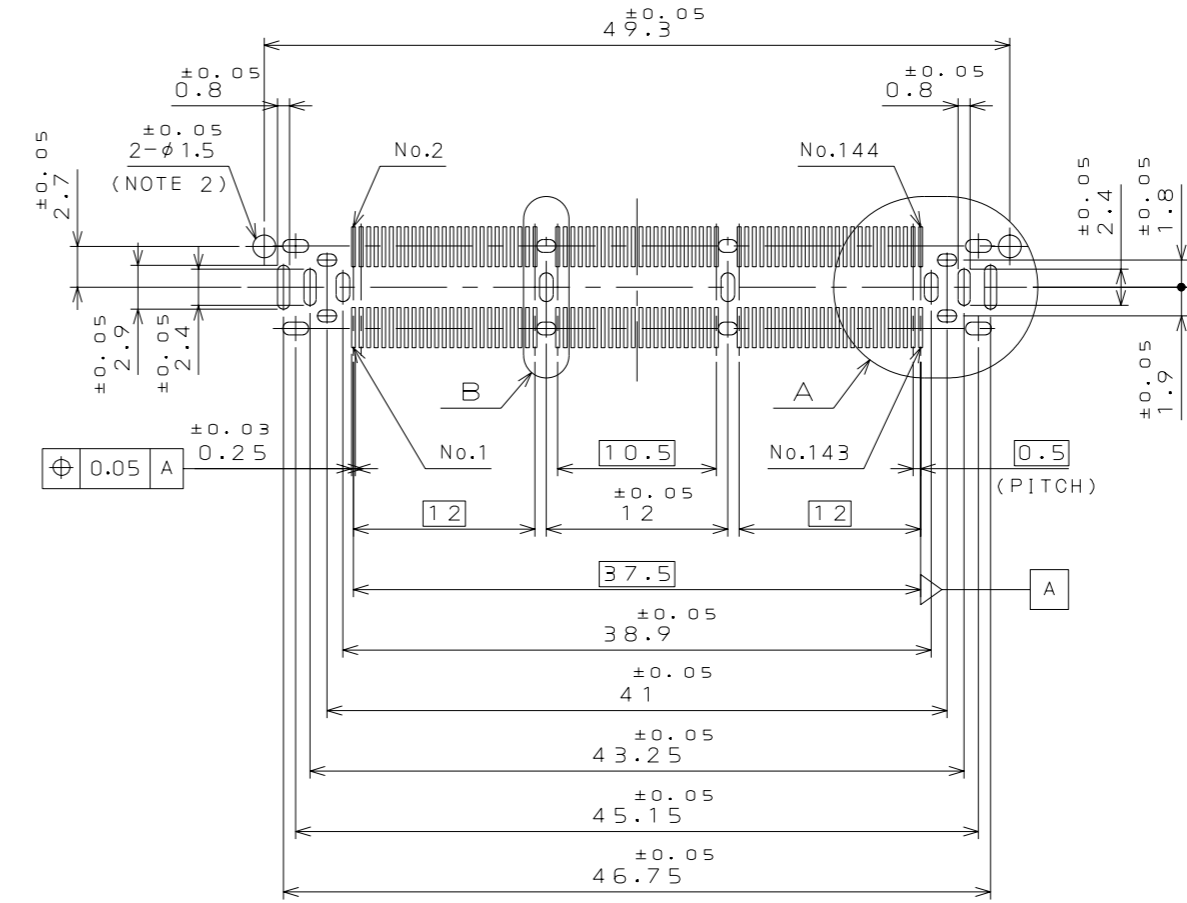
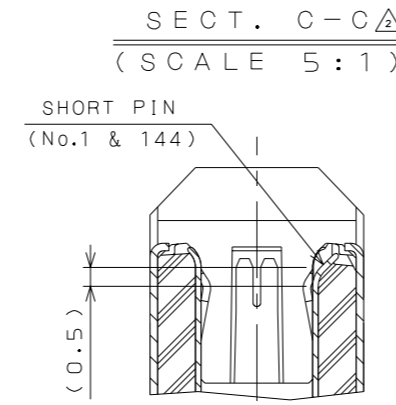
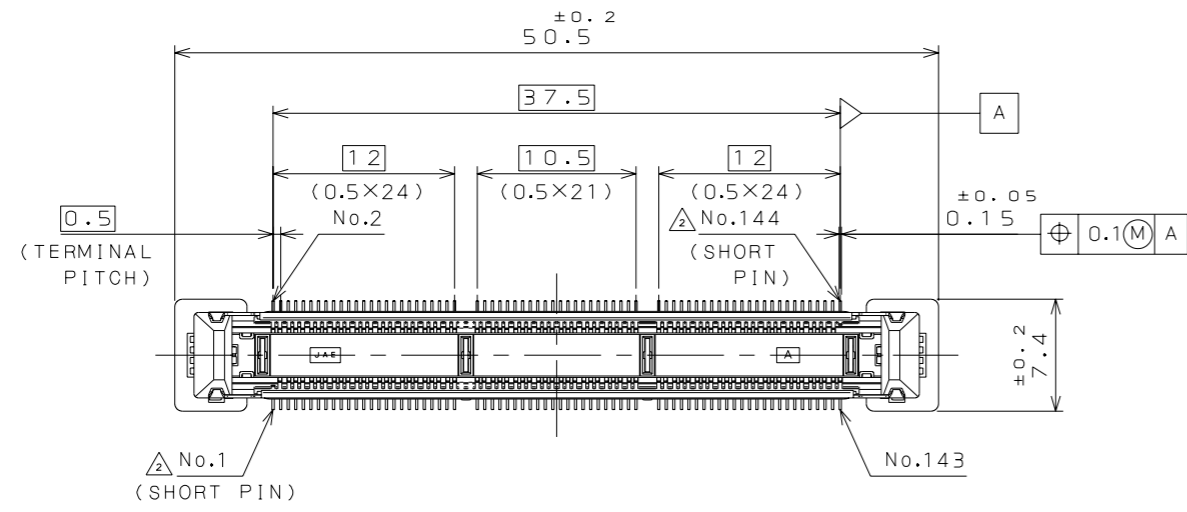
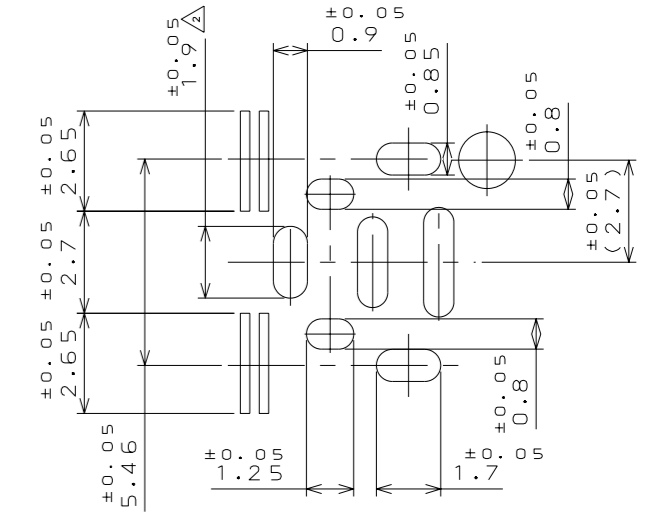


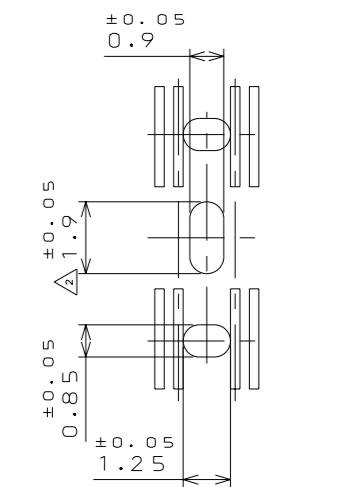
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	28.Jan.2008	064913	REVISED DIMENSION		M.SASAKI		K.HISATOMI



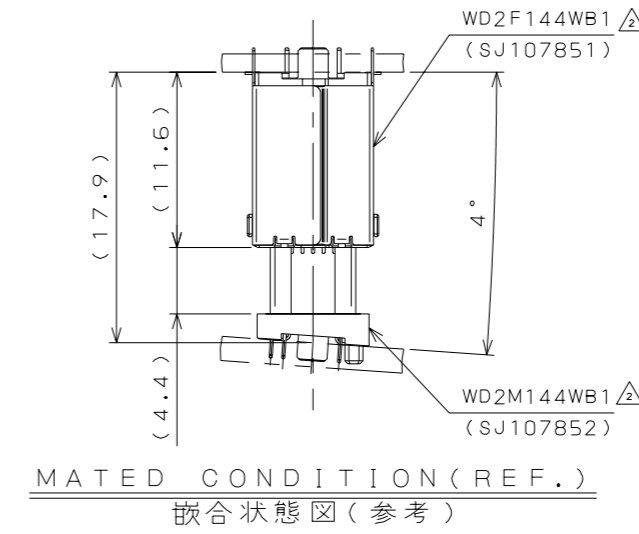
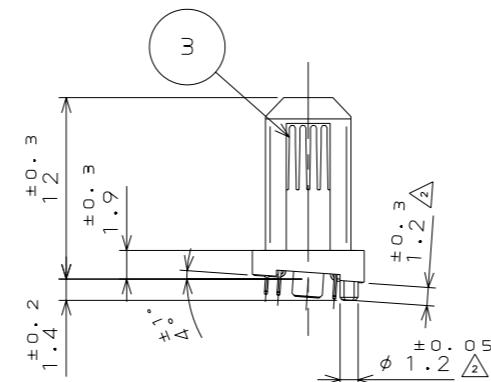
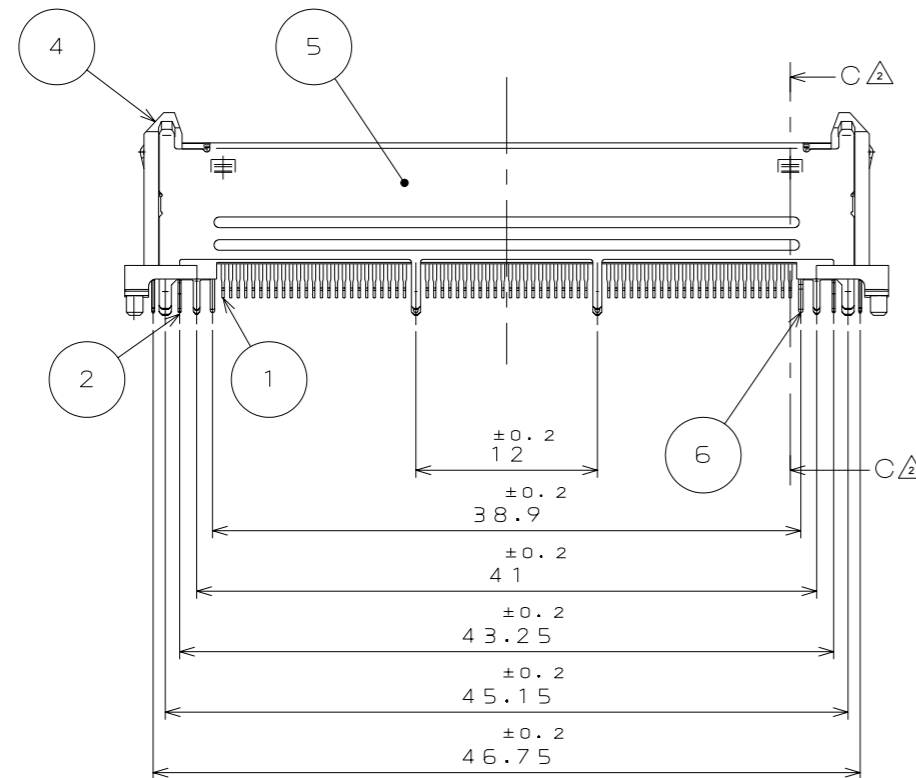
APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)  
適合基板寸法 (参考)



DETAIL A  
(SCALE 5:1)



DETAIL B  
(SCALE 5:1)



MATED CONDITION (REF.)  
嵌合状態図 (参考)

TABLE 1

	SIGNAL CONTACT 信号コンタクト	POWER CONTACT #1 & #2 電源コンタクト #1 & #2
CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au 0.3μm以上	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au 0.3μm以上
SOLDERING AREA 半田付部	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	TIN PLATING OVER NICKEL Ni上Sn

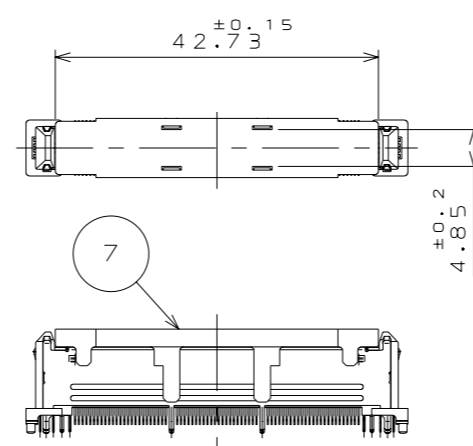
△	品名	数量	材料	仕上	備考
7	CAP	1	GLASS FILLED PPS		
6	HOLD PIN	4	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
5	SHELL	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
4	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		UL94V-0 COLOR:BLACK
3	POWER CONTACT#2	2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
2	POWER CONTACT#1	2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
1	SIGNAL CONTACT	144	COPPER ALLOY	TABLE 1	

NOTE 1. TERMINAL COPLANARITY IS 0.1mmMAX.

NOTE 2. ALL HOLES, EXCEPT FOR 1.5mm DIA. HOLES AS SHOWN, NEED TO BE THROUGH-HOLE PLATING.

注1. 端子平坦度は0.1mm以下

注2. 図示の穴(φ1.5)以外の穴は、スルーホールめっきを施すこと。



CAP ASSEMBLED CONDITION  
キャップ組込み状態図

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)					
第1版 (ORIGINAL DATE)			12.JUL.2007		尺度 (SCALE)
製図 DR.			M.SASAKI		シリーズ (SERIES)
担当 CHK.			M.SASAKI		WD2
査閲 APPD.					名称 (TITLE)
承認 APPD.			K.HISATOMI		WD2M144WB1
公差 (GENERAL TOLERANCE)					質量 (MASS)
寸法 (DIMENSION)			° ±		
. ± 0.8			° × ±		
.X ± 0.4			° × × ±		
.XX ± 0.1					
.XXX ±					

日本航空電子工業株式会社  
JAPAN AVIATION  
ELECTRONICS  
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ107852

版数 (REV.)  
2